

中華民國經濟部智慧財產局

INTELLECTUAL PROPERTY OFFICE
MINISTRY OF ECONOMIC AFFAIRS
REPUBLIC OF CHINA

茲證明所附文件，係本局存檔中原申請案的副本，正確無訛，
其申請資料如下：

This is to certify that annexed is a true copy from the records of this
office of the application as originally filed which is identified hereunder:

申請日：西元 2001 年 01 月 04 日
Application Date

申請案號：090100177
Application No.

申請人：邱雯雯
Applicant(s)

局長
Director General

陳明邦

發文日期：西元 2001 年 2 月 5 日
Issue Date

發文字號：
Serial No. 09011001290

申請日期	
案 號	
類 別	

A4
C4

(以上各欄由本局填註)

發 明 專 利 說 明 書		
一、發明 名稱	中 文	積體電路晶片之構裝
	英 文	
二、發明 人	姓 名	邱 雯 雯
	國 籍	中 華 民 國
	住、居所	新竹市東區龍山里光復路一段 576 巷 16 弄 15 號
三、申請人	姓 名 (名稱)	邱 雯 雯
	國 籍	中 華 民 國
	住、居所 (事務所)	同 上
	代 表 人 名 姓 名	

裝 訂 線

四、中文發明摘要(發明之名稱：)

積體電路晶片之構裝

本發明係有關於一種積體電路晶片之構裝，主要包含有一承載板、一晶片、一黏著物、一遮蓋及一間隔裝置，其中該承載板，具有一頂面及一底面，且該頂面佈設有多數之鐳墊；該晶片，係固設於該承載板頂面，該晶片具有多數之鐳墊，並藉由多數之鐳線而分別與該承載板之鐳墊連接；該黏著物，係佈設於該承載板頂面周緣；而該間隔裝置，係銜接該承載板與該遮蓋，用以使該遮蓋可間隔一預定距離地罩設於該承載板頂面上方，俾使該晶片得與外界隔離者。

英文發明摘要(發明之名稱：)

(請先閱讀背面之注意事項再填寫本頁各欄)

裝

訂

線

五、發明說明()

本發明係與積體電路晶片之構裝有關，特別是指一種小尺寸積體電路晶片之構裝結構。

請參閱第一圖，為一種習用之積體電路晶片之構裝(10)，該構裝(10)大體上包含有一承載體(11)、一晶片(12)及一遮蓋(13)，其中該承載體(11)具有一開口向上之容室(14)，該容室(14)之底部佈設有預定數目及態樣之鉅墊(16)，該晶片(12)則黏著固接於該容室(14)底部中央位置上，並藉由鉅線(17)與各該鉅墊(16)電性連接，而該遮蓋(13)，係用以封抵住該承載體(11)之開口端，使該晶片(12)可與外界隔離，以保護該晶片(12)不受外力破壞或雜物污染，且當該晶片(12)係為影像用晶片時，該遮蓋(13)則為透明物質所製成。其次，請參閱第二圖，為另一種習用之構裝(20)，其結構大體上與前一習用構裝(10)相仿，申請人在此容不贅述。

上述構裝(10)，因該容室(14)底部必須同時容裝晶片(12)以及承載體(11)之鉅墊(16)，且晶片(12)與該容室(14)之壁面之間，必須提供足夠之空間供打線器活動，以致該容室(14)底部之面積，將遠大於晶片本身之面積，而大幅增加整個構裝之體積，如此一來，對於現行電子產品"輕、薄、短、小"之體積訴求而言，此等構裝方式並非十分適用。

其次，上述構裝(10)之承載體(11)，一般係採用強化塑膠材質、陶瓷等材質之印刷電路板製造，必須進一步加工容納晶片之凹陷容室，整體製程顯得較為複雜。

緣此，本發明之主要目的在於提供一種積體電路晶片

(請先閱讀背面之注意事項再填寫本頁)

裝

訂

線

五、發明說明()

之構裝，可大幅縮小其整體構裝體積者。

本發明之又一目的在於提供一種積體電路晶片之構裝，其結構簡單，加工組裝容易者。

- 為達成上述之目的，本發明所提供之一種積體電路晶片之構裝，包含有：一承載板，具有一頂面及一底面，且該頂面佈設有多數之鐳墊；至少一晶片，係固設於該承載板頂面，該晶片具有多數之鐳墊；多數之鐳線，係分別電性連接該承載體之鐳墊與該晶片之鐳墊；一黏著物，係佈設於該承載板頂面周緣；一遮蓋；一間隔裝置，係銜接該承載板與該遮蓋，用以使該遮蓋可間隔一預定距離地罩設於該承載板頂面上方者。

為使 審查委員能詳細瞭解本發明之實際構造及特點，茲列舉以下實施例並配合圖示說明如后，其中：

- 第一圖係一種習用積體電路晶片之構裝；
15 第二圖係另一種習用積體電路晶片之構裝；
第三圖係本發明第一較佳實施例之立體組合圖；
第四圖係第三圖沿剖線 4-4 方向之剖視圖；
第五圖係本發明第一較佳實施例之頂視圖；
第六圖係本發明第二較佳實施例之剖視圖；
20 第七圖係本發明第三較佳實施例之剖視圖；
第八圖係本創作第四較佳實施例之剖視圖；
第九圖係本創作第五較佳實施例之剖視圖；
第十圖係本創作第六較佳實施例之剖視圖；
第十一圖係本創作第七較佳實施例之剖視圖。
25 請先參閱第三至第五圖，係本發明第一較佳實施例所

(請先閱讀背面之注意事項再填寫本頁)

裝

訂

線

五、發明說明()

提供之積體電路晶片構裝(30)，主要包含有一承載板(31)、一晶片(32)、多數之鐸線(33)、一黏著物(34)、一遮蓋(35)、一間隔裝置(36)及一連接裝置(37)，其中：

該承載板(31)，係可為塑膠、玻璃纖維、強化塑膠、陶瓷...等材質所製成之電路板(Printed Circuit Board, PCB)，其具有一頂面(31a)及一底面(31b)，且該頂面(31a)周緣佈設有多數之鐸墊(31c)。

該晶片(32)，係固定於承載板(31)頂面(31a)中央位置，且該晶片(32)之表面具有多數之鐸墊(32b)。

各該鐸線(33)，係由黃金或鋁等金屬材質製成，係利用打線器(圖中未示)先以其一端與該晶片(32)之鐸墊(32b)連接，其另一端再與該承載板(31)之鐸墊(31c)連接。

該黏著物(34)，係可為矽樹脂(Silicones)、環氧樹脂(Epoxyes)、丙烯酸樹脂(Acrylics)、聚醯亞胺(Polyamides)、低熔點之玻璃或雙面膠帶等材質所構成，該黏著物(34)係佈設於該承載板(31)頂面(31a)，並覆蓋保護著各該鐸線(33)與該承載板(31)鐸墊(31c)之銜接處。

該遮蓋(35)，具有一由不透明之塑膠、金屬或透明之玻璃、塑膠等材質所製成之板件，其具有一頂面(35a)以及一底面(35b)。

而該間隔裝置(36)，其主要功能係銜接該承載板(31)與該遮蓋(35)，用以使該遮蓋(35)可間隔一預定距離地罩設於該承載板(31)頂面(31a)上方；本實施例中，該間隔裝置(36)包含有四定位柱(36a)，各該定位柱(36a)之一端係一體銜接於該遮蓋(35)底面(35b)四個角落，而各該定位柱(36a)

(請先閱讀背面之注意事項再填寫本頁)

裝

訂

線

五、發明說明()

之另一端則抵接於該承載板(31)頂面(31a)，並使該遮蓋(35)之底面(35b)周緣可與該黏著物(34)固接，藉此，可隔離該晶片(32)與外界，以保護該晶片(32)不受外力破壞或雜物污染。

- 5 而該連接裝置(37)，其主要功能係用以電性連接該承載板上之鐳墊(31c)至該承載板外部；本實施例中，該連接裝置(37)係為開設於該承載板(31)周緣，用以連通該承載板(31)頂面(31a)鐳墊(31c)至該承載板(31)底面(31b)之多數貫孔(37a)(through hole)，藉此，該構裝(30)可藉由鐳錫電性
- 10 連接於一外界電路板(圖中未示)上。

- 藉由上述之組合，該積體電路晶片構裝(30)，該承載板(31)頂面(31a)周緣，係為一開放之空間，可供打線器自由活動，因此該承載板(31)之面積，可儘其可能地縮小至與該晶片(32)之面積幾近相同，故可大幅地縮小該構裝(30)
- 15 之整體體積，以達到晶片尺寸般構裝(chip size package)之目的；其次，該承載板(31)可利用現行之電路板製造，不須再額外加工，故整體結構較習用技術更為簡單、組裝更為容易。

- 請參閱第六圖，係本發明第二較佳實施例所提供之積
- 20 體電路晶片構裝(40)，其結構大體上與前一實施例相仿，惟其差異在於：

該間隔裝置之定位柱(42)之一端，係嵌置於該承載板(44)頂面凹設之定位孔(44a)中，俾使該遮蓋(46)可穩固地罩設於該承載板(44)上。

- 25 請參閱第七圖，係本發明第三較佳實施例所提供之積

(請先閱讀背面之注意事項再填寫本頁)

裝

訂

線

五、發明說明 ()

體電路晶片構裝(50)，其結構大體上與前一實施例相仿，惟其差異在於：

該承載板(52)設有貫穿其頂、底面之定位孔(52a)，而該間隔裝置之定位柱(54)之一端，係穿過該定位孔(52a)並突露於該承載板(52)底面，以作為該構裝(50)裝設於外界電路板上時之定位點者。

請參閱第八圖，係本發明第四較佳實施例所提供之積體電路晶片構裝(60)，主要包含有一承載板(61)、一影像用晶片(62)、多數之鐸線(63)、一黏著物(64)、一遮蓋(65)、一間隔裝置(66)及一連接裝置(67)，本實施例與上述各實施例之差異在於：

該遮蓋(65)，具有一頂面(65a)、一底面(65b)以及貫穿其頂底面(65a)(65b)之穿孔(65d)，該穿孔(65d)中封設有若干鏡片(65e)，藉此光線可透過該鏡片(65e)照射於該晶片(62)上。

其次，該間隔裝置(66)，係為一框體(66a)，其頂端(66b)係抵接於該遮蓋(65)底面(65b)，而該框體(66a)之底端(65c)，係與該黏著物(64)銜接固定。

而該連接裝置(67)，本實施例中，係包含有電性連通該承載板(61)頂面鐸墊至該承載板(61)底面之多數貫孔(67a)(through hole)，以及佈植於該承載板(61)底面，與各該貫孔(67a)電性連接之多數個鐸球(67b)(solder ball)者。

請參閱第九圖，係本發明第五較佳實施例所提供之積體電路晶片構裝(70)，主要包含有一承載板(71)、一影像用晶片(72)、多數之鐸線(73)、一黏著物(74)、一遮蓋(75)、

(請先閱讀背面之注意事項再填寫本頁)

裝

訂

線

五、發明說明 ()

一間隔裝置(76)以及一連接裝置(77)，本實施例與上述各實施例之差異在於：

該遮蓋(75)，具有一貫穿其頂、底面(75a)(75b)之螺孔(75c)及一鏡頭(75d)；該鏡頭(75d)，具有一筒體(75f)及封
5 設於該筒體(75f)中之鏡片(75g)，且該筒體(75f)係鎖合於該螺孔(75c)中者。在此需說明的是，該鏡頭(75d)利用螺紋鎖合方式與該螺孔(75c)銜接，可方便調整該鏡頭(75d)至該晶片(72)之距離(焦距)，惟其亦可採用他種固定方式者。

其次，該間隔裝置(76)，本實施例中係為一框體(76a)，
10 其頂端(76b)係與該遮蓋(75)底面(75b)銜接，其底端(76c)則抵接於該承載板(71)頂面，且該框體(76a)鄰近該承載板(71)位置具有一凹陷部(76d)，可以容置該黏著物(74)者。

再者，該連接裝置(77)，於本實施例中，包含有多數之金屬接腳(77a)(lead)，各該接腳(77a)之一端(77b)係與該
15 承載板(71)頂面鉗墊電性連接，另一端(77c)則位於該承載板(71)外部並彎折成預定形狀者。

請參閱第十圖，係本發明第六較佳實施例所提供之積體電路晶片構裝(80)，主要包含有一承載板(81)、一影像用晶片(82)、多數之鉗線(83)、一黏著物(84)、一遮蓋(85)一
20 間隔裝置(86)以及一連接裝置(87)，本實施例與上述各實施例之差異在於：

該連接裝置(87)，於本實施例中，包含有多數之金屬接腳(87a)(lead)，各該接腳(87a)之一端(87b)係固設於該承載板(81)之頂面上，位於該晶片(82)之周緣，且各該接腳

(請先閱讀背面之注意事項再填寫本頁)

裝

訂

線

五、發明說明 ()

(87a)之該端(87b)上具有一鐸墊(圖中未示)，並藉由該鐸墊與該鐸線(83)連接，而該接腳(87a)之另一端(87c)則位於該承載板(81)外部並彎折成預定形狀者。

其次，該間隔裝置(86)，其底端(86a)係壓接於該接腳一端(87b)上，且該底端(86a)具有一凹陷部(86b)，用以容納該黏著物(84)。

請參閱第十一圖，係本發明第七較佳實施例所提供之積體電路晶片構裝(90)，主要包含有一承載板(91)、一影像用晶片(92)、多數之鐸線(93)、一黏著物(94)、一遮蓋(95)、一
10 間隔裝置(96)以及一連接裝置(97)，本實施例與上述各實施例之差異在於：

該承載板(91)之頂面尚佈設有若干電子元件(91a)，各該元件(91a)並佈線(圖中未示)與該承載體(91)頂面之鐸墊(圖中未示)電性連接，如此一來，該構裝(90)可成為一具特
15 定功能之模組使用。

綜上所陳，本發明積體電路晶片之構裝，確實具有體積小及結構簡單組裝容易之優點，故本發明之實用性與進步性當毋庸置疑，今為保障申請人之權益，遂依法提出專利申請，祈請 審查委員詳加審查，並早日賜准本案專
20 利，則為申請人是幸。

(請先閱讀背面之注意事項再填寫本頁)

裝

訂

線

五、發明說明()

「圖示之簡單說明」

- 第一圖係一種習用積體電路晶片之構裝；
 第二圖係另一種習用積體電路晶片之構裝；
 第三圖係本發明第一較佳實施例之立體組合圖；
 5 第四圖係第三圖沿剖線 4-4 方向之剖視圖；
 第五圖係本發明第一較佳實施例之頂視圖；
 第六圖係本發明第二較佳實施例之剖視圖；
 第七圖係本發明第三較佳實施例之剖視圖；
 第八圖係本創作第四較佳實施例之剖視圖；
 10 第九圖係本創作第五較佳實施例之剖視圖；
 第十圖係本創作第六較佳實施例之剖視圖；
 第十一圖係本創作第七較佳實施例之剖視圖。

「圖號說明」

『第一實施例』

- | | | | |
|----|----------|-----------|----------|
| 15 | 構裝(30) | 承載板(31) | 頂面(31a) |
| | 底面(31b) | 鉅墊(31c) | 晶片(32) |
| | 鉅墊(32b) | 鉅線(33) | 黏著物(34) |
| | 遮蓋(35) | 頂面(35a) | 底面(35b) |
| | 間隔裝置(36) | 四定位柱(36a) | 連接裝置(37) |
| 20 | 貫孔(37a) | | |

『第二實施例』

- | | | |
|----------|---------|---------|
| 構裝(40) | 定位柱(42) | 承載板(44) |
| 定位孔(44a) | 遮蓋(46) | |

『第三實施例』

(請先閱讀背面之注意事項再填寫本頁)

裝

訂

線

五、發明說明()

	構裝(50)	承載板(52)	定位孔(52a)
	定位柱(54)		
	『第四實施例』		
	構裝(60)	承載板(61)	晶片(62)
5	鐳線(63)	黏著物(64)	遮蓋(65)
	頂面(65a)	底面(65b)	穿孔(65d)
	鏡片(65e)	間隔裝置(66)	框體(66a)
	頂端(66b)	底端(65c)	連接裝置(67)
	貫孔(67a)	鐳球(67b)	
10	『第五實施例』		
	構裝(70)	承載板(71)	晶片(72)
	鐳線(73)	黏著物(74)	遮蓋(75)
	頂面(75a)	底面(75b)	螺孔(75c)
	鏡頭(75d)	筒體(75f)	鏡片(75g)
15	間隔裝置(76)	框體(76a)	頂端(76b)
	底端(76c)	凹陷部(76d)	連接裝置(77)
	接腳(77a)	接腳一端(77b)	接腳另一端(77c)
	構裝(70)	承載板(71)	晶片(72)
	『第六實施例』		
20	構裝(80)	承載板(81)	晶片(82)
	鐳線(83)	黏著物(84)	遮蓋(85)
	間隔裝置(86)	底端(86a)	凹陷部(86b)
	連接裝置(87)	接腳(87a)	接腳一端(87b)
	接腳另一端(87c)		
25	『第七實施例』		

(請先閱讀背面之注意事項再填寫本頁)

裝

訂

線

五、發明說明()

構裝(90)

承載板(91)

晶片(92)

鐳線(93)

黏著物(94)

遮蓋(95)

間隔裝置(96)

連接裝置(97)

電子元件(91a)

(請先閱讀背面之注意事項再填寫本頁)

裝

訂

線

六、申請專利範圍

- 1.一種積體電路晶片之構裝，包含有：
- 一承載板，具有一頂面及一底面，且該頂面佈設有多數之鐸墊；
- 至少一晶片，係固設於該承載板頂面，該晶片具有多
- 5 數之鐸墊；
- 多數之鐸線，係分別電性連接該承載體之鐸墊與該晶片之鐸墊；
- 一黏著物，係佈設於該承載板頂面周緣；
- 一遮蓋；
- 10 一間隔裝置，係銜接該承載板與該遮蓋，用以使該遮蓋可間隔一預定距離地罩設於該承載板頂面上方者。
- 2.依據申請專利範圍第 1 項所述之構裝，其中該黏著物佈設於該承載板頂面周緣時，係覆蓋保護著各該鐸線與該承載板頂面鐸墊之連接處者。
- 15 3.依據申請專利範圍第 1 項所述之構裝，其中該遮蓋更與該黏著物銜接固定者。
- 4.依據申請專利範圍第 1 項所述之構裝，其中該間隔裝置，包含有至少一定位柱，係夾置固接於該承載板與該遮蓋之間者。
- 20 5.依據申請專利範圍第 4 項所述之構裝，其中該承載板頂面凹設有至少一定位孔，且該定位柱之一端係嵌置固定於該定位孔中。
- 6.依據申請專利範圍第 4 項所述之構裝，其中該承載板設有至少一貫穿該承載板頂、底面之定位孔，且該定位柱之一端係穿過該定位孔，並突露出該承載板底面者。
- 25 7.依據申請專利範圍第 1 項所述之構裝，其中該間隔裝置，包含有一框體，係夾置固接於該承載板與該遮蓋之

(請先閱讀背面之注意事項再填寫本頁)

裝

訂

線

六、申請專利範圍

間。

8.依據申請專利範圍第7項所述之構裝，其中該框體，其鄰近該承載板位置具有一凹部，可供該黏著物容置者。

9.依據申請專利範圍第1項所述之構裝，其中該遮蓋
5 係為透明材質所製成者。

10.依據申請專利範圍第1項所述之構裝，其中該遮蓋具有一通孔，該通孔係對應該晶片，且該通孔中至少封設固定有一鏡片者。

11.依據申請專利範圍第1項所述之構裝，其中該遮蓋
10 具有：

一螺孔，係貫穿該遮蓋之頂底面，並對應該晶片；

一鏡頭，具有一筒體以及至少一封設於該筒體中之鏡片，且該筒體係鎖合於該螺孔中者。

12.依據申請專利範圍第1項所述之構裝，其中該承載
15 板，係為一選自塑膠、強化塑膠、玻璃纖維或陶瓷等材料之一所製成者。

13.依據申請專利範圍第1項所述之構裝，其中該黏著物，係選自矽樹脂(Silicones)、環氧樹脂(Epoxies)、丙烯酸樹脂(Acrylics)、聚醯亞胺(Polyamides)、玻璃等材質之一所
20 製成者。

14.依據申請專利範圍第1項所述之構裝，其中該黏著物，係為一雙面膠帶者。

15.依據申請專利範圍第1項所述之構裝，其中該承載板頂面更佈設有若干電子元件，係與位於該承載板頂面之
25 鉅墊電性連接者。

16.依據申請專利範圍第1項所述之構裝，更包含有一連接裝置，係用以電性連接該承載板上之鉅墊至該承載板

(請先閱讀背面之注意事項再填寫本頁)

裝

訂

線

六、申請專利範圍

外部者。

17.依據申請專利範圍第 16 項所述之構裝，其中該連接裝置，係為開設於該承載板周緣，用以連通該承載板頂面銲墊至該承載板底面之多數貫孔者。

- 5 18.依據申請專利範圍第 16 項所述之構裝，其中該連接裝置，包含有多數貫孔及銲球，其中各該貫孔，係電性連接該承載板頂面銲墊至該承載板之底面，而各該銲球，係佈植於該承載板之底面，並分別與各該貫孔電性連接者。

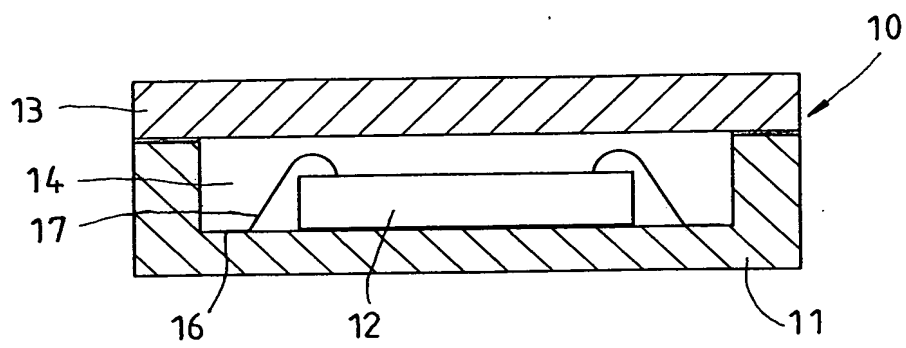
- 10 19.依據申請專利範圍第 16 項所述之構裝，其中該連接裝置，係為多數之金屬接腳，各該接腳之一端係與位於該承載板頂面之銲墊電性連接，另一端則位於該承載板外部並彎折成預定形狀者。

(請先閱讀背面之注意事項再填寫本頁)

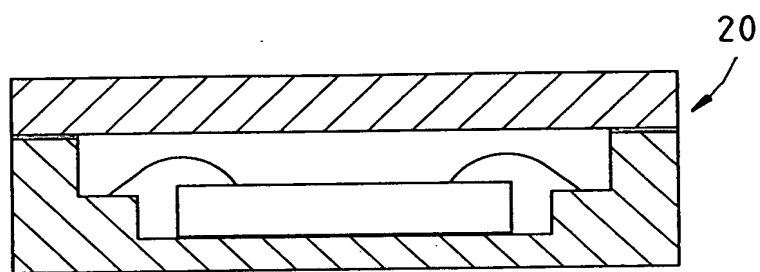
裝

訂

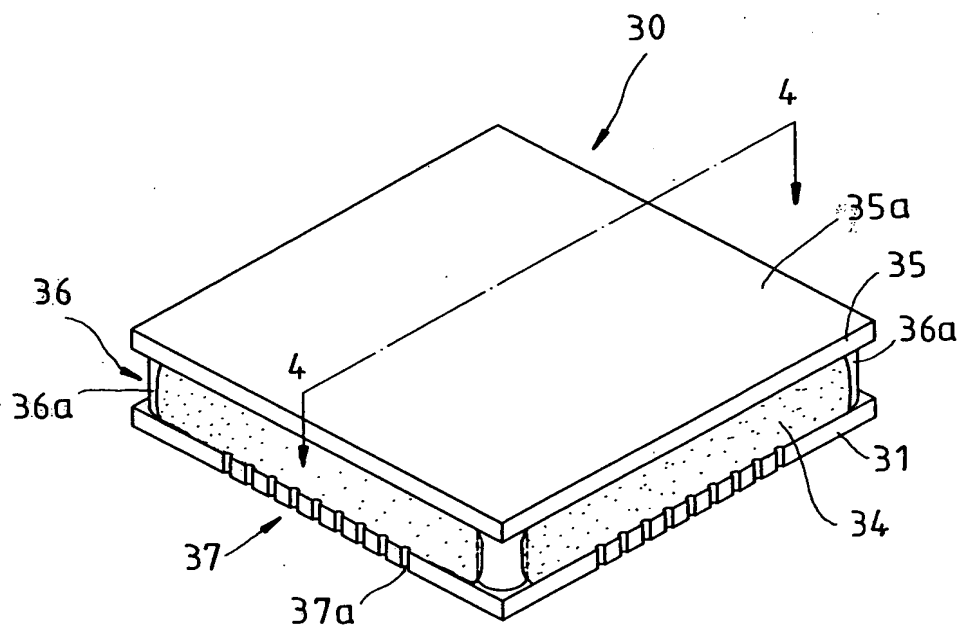
線



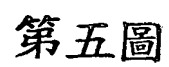
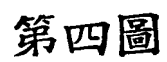
第一圖

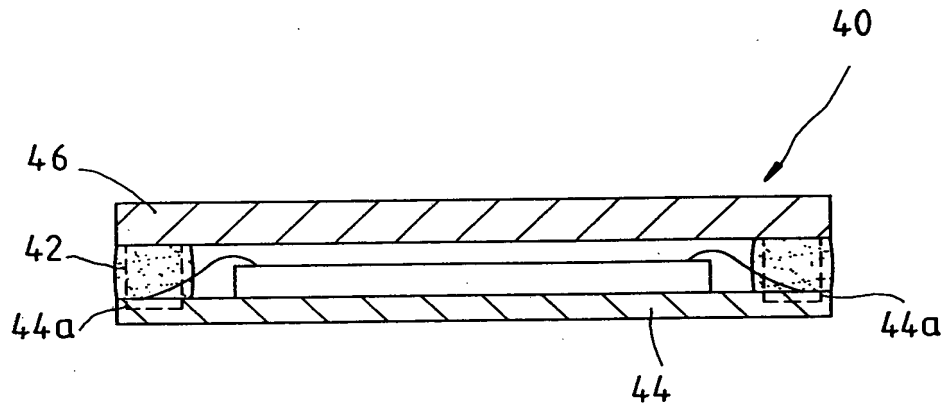


第二圖

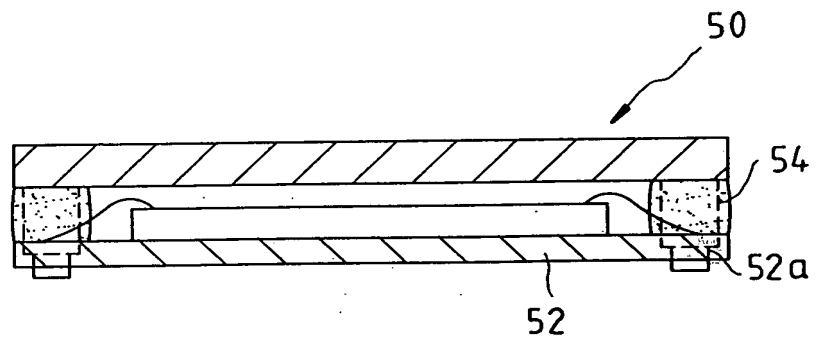


第三圖

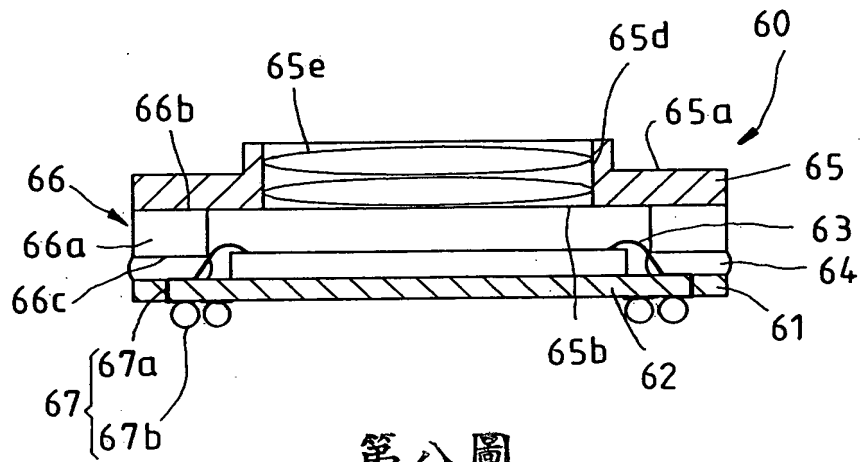




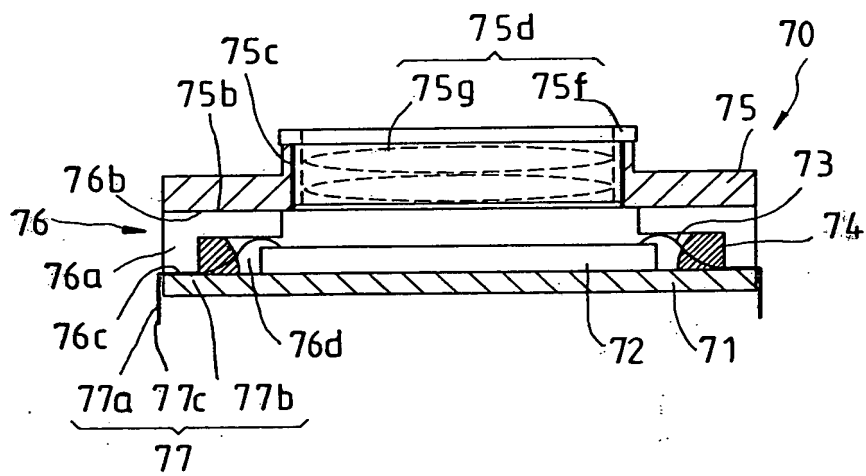
第六圖



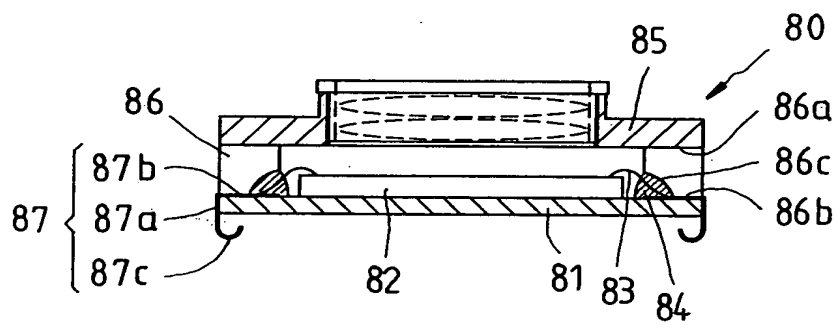
第七圖



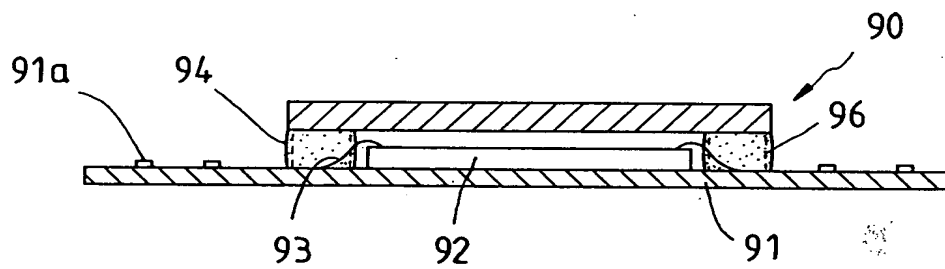
第八圖



第九圖



第十圖



第十一圖